

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2026-056

深圳市大族数控科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深交所关于“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，经公司董事会批准，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、深耕 PCB 专用设备领域，推动公司高质量发展

大族数控深耕印刷线路板（PCB）专用加工设备产业二十余年，专注于为 PCB 行业提供差异化的一站式解决方案，产品涵盖 PCB 各细分市场的压合、钻孔、曝光、成型、质量检测等关键工序，是全球 PCB 专用设备产业中产品布局最广泛企业之一，已连续十七届获得 CPCA（中国电子电路行业协会）百强排行榜仪器及专用设备类第一名，且营收规模显著领先，行业领先地位稳固。

受 AI 算力基础设施大规模投资的带动，PCB 产业迎来高质量黄金发展期；且随着 AI 服务器系统数据吞吐量的大幅成长，PCB 不再只扮演信号传输的角色，更是决定整个系统效率和可靠度的关键因素，促使 AI PCB 的技术难度不断攀升。而高性能 AI PCB 的精密制造，高度依赖高技术附加值专用设备的强力支撑，这正驱动 PCB 专用设备升级为 AI 算力产业的核心资产。

未来，公司将持续围绕“成为世界范围内最受尊敬和信赖的 PCB（装备）服务商”这一愿景，聚焦 AI 场景，为下游客户提供领先的解决方案，并赋能下游客户向先进封装（Advanced Packaging）产业链延伸。

1、聚焦市场增速快、技术门槛更高的 AI 算力场景，公司持续推高核心钻

孔工序解决方案的市场尖刀地位，同步发挥多产品、多场景的协同优势，不断研发适应 AI 算力场景技术的、具有市场竞争力的、覆盖高阶 PCB 生产全流程核心工序的智能制造解决方案。

2、公司将以打造核心工序解决方案为切入点，与下游龙头 PCB 制造商、上游关键器件供应商及 PCB 关键原材料厂商紧密合作，全面掌握行业内领先的生产技术和工艺变化趋势，构建起产业链上中下游一体化的研发联动机制。

3、公司将致力于变革现有价值链体系，加大现有专用设备周边的价值挖掘，通过对 PCB 行业新技术、新材料、新工艺与专用加工设备的研发整合，打造大族数控品牌的系统性工序解决方案，大幅提升 PCB 加工的效率与品质，赋能行业价值提升。

4、公司将持续提升服务能力，发挥快速响应的服务优势，为客户提供从技术咨询、设备选型到运行维护、技术升级的全生命周期式增值服务；并积极布局海外供应及服务体系，服务 PCB 产业全球多元化的发展趋势，从而提升全球竞争力。

二、坚持自主创新驱动，不断增强核心竞争力

公司始终坚持技术的自主创新，持续加大研发投入力度，在 PCB 专用设备领域累积了丰富研究成果，并已形成了完善的研发体系，近三年公司平均研发投入占营业收入的比例达 8.54%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计取得 255 项发明专利、812 项实用新型及外观专利、369 项软件著作权，专利申请数量合计超 2,000 项。

公司构建了工艺研究平台、产品研发平台、通用技术平台三位一体的独特研发体系，三大平台协同发展，各有侧重又有机互补，工艺研究平台深耕客户现场，持续挖掘客户痛点及堵点；产品研发平台针对客户需求逐项拆解，不断优化现有产品或研发新型产品，针对性地为客户解决不同难题；通用技术平台则提供共性技术支援，优先整合全球最优秀的供应链技术，快速赋能产品方案的技术提升。同时，公司重点建设面向高阶 PCB、先进封装与新材料工艺认证的高等级实验室，建立与材料厂商、核心客户联合开展前沿产品开发的机制，把控新产品技术发展方向。

公司持续优化人才结构，深入实施人才先行战略。近年来，公司研发团队规模持续壮大，硕士及以上学历核心人才占比持续攀升，高学历研发人才储备

为公司提供了坚实的技术创新底座与核心人才保障，全面赋能公司向“全球市场开拓与技术引领型”企业转型。

公司积极拥抱 AI 变革，构建数字智能化发展路径，大力推进 AI 应用平台建设，开发并上线了覆盖业务运营、财务、人力资源等维度的多模态智能体（AI Agents），推进内部流程智能化升级的同时，加速核心数据资产的沉淀与管理变革，在 PCB 专用加工设备领域率先实现数字智能化转型，抢占 AI 时代的竞争先机。

未来，公司将继续保持与上游供应链企业及原材料龙头企业的高频战略合作，在下一代 AI 服务器 PCB 板、mSAP 工艺方案、先进封装基板成套方案等领域持续加大技术投入，不断积累研发成果，及时针对不同场景下 PCB 材料配方的变化以及产品结构的升级打造更优的解决方案，助力 PCB 行业高潜力场景的发展。

三、完善公司治理，不断提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，持续完善公司治理及内部控制体系，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。同时强化控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”的责任意识，提升公司治理和决策水平，增强风险防范能力。

公司严格按照法律法规的要求，持续完善制度建设，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度进行修订，并制定了《可持续发展（ESG）管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，为公司持续规范运作提供制度保障。

未来，公司将进一步完善法人治理结构及内部控制体系，提升公司治理水平，提高股东回报，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司的经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力、全面风险管理能力和可持续发展能力，实现可持续的高质量发展。

四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

在信息披露方面，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办

法》等法律法规、规范性文件的规定，认真履行各项信息披露义务，突出信息披露内容的重要性和针对性，并在信息披露过程中严格执行《内幕信息知情人管理制度》，持续做好内幕信息管理事项，提高信息透明度和信息披露质量。

在投资者关系管理方面，公司积极拓展投资者沟通渠道，充分利用投资者热线、互动易平台、业绩说明会、股东会、投资者现场调研等多种形式加强与投资者的双向沟通，全面展示公司经营情况及战略规划，加深投资者对公司的认识。

未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露，提升信息披露的质量与深度，同时加强投资者关系管理工作，构建良性互动的投资者关系体系，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。

五、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司在追求自身高质量可持续发展的同时，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。自 2022 年上市以来，公司已实施现金分红 5 次，累计派发现金分红约 18.26 亿元人民币，未来，公司将继续根据所处发展阶段，在符合利润分配原则前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，构建“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，切实与投资者分享公司成长和发展成果。

公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，坚定执行战略发展规划，持续提升核心竞争能力，同时加强内部控制建设，推动公司实现高质量可持续发展，切实增强投资者的信心，共同促进资本市场健康发展。

本行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日